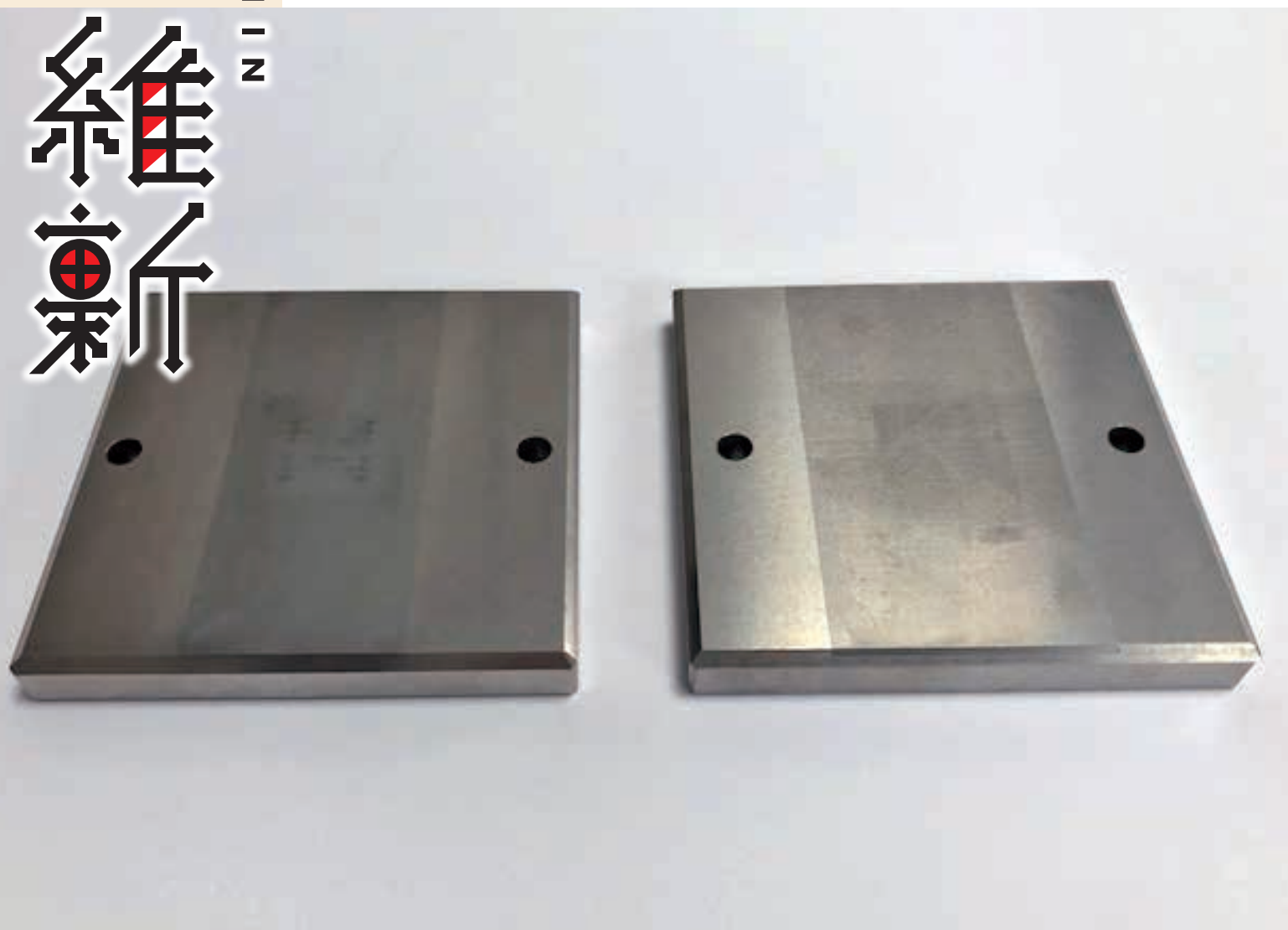


ウェアラブル端末用セラミック積層品の高性能化・微細化の実現

ウェアラブル端末に組み込まれている電子部品（セラミック積層品）の高性能化・微細化を実現するために必要な極小セラミック積層デバイス金型の製作において、最重要課題である極小穴連続無人加工技術を確立し、極小セラミックデバイス市場の獲得を目指す。



下型プレート（左φ0.06、右φ0.12）

事業のきっかけや目的

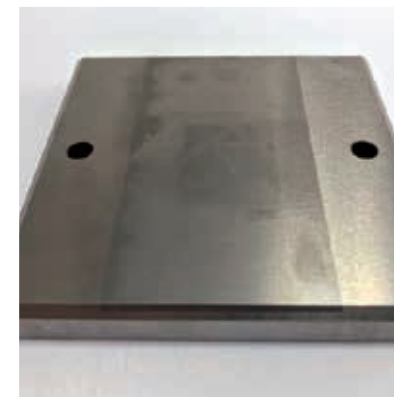
ウェアラブル端末は「時計型」「リストバンド型」「メガネ型」等の実用化、「指輪型」「コンタクトレンズ型」等の開発が進んでおり、今後ますます高性能化・小型化・軽量化の要求が高くなる。ニーズに応えるには端末に組み込まれる電子部品（セラミック積層品）の金型においても高精度な加工技術が必要不可欠なため、細穴放電加工機を導入する。

事業の取り組み内容と成果

超硬プレートは、通常のドリル加工での対応ができなため、深穴加工用の中間ガイド仕様と多数穴連続加工用の電極自動送り出し仕様の2つの機能を兼ね備えた細穴放電加工機を導入。その結果、φ0.1タングステン電極、φ0.08タングステン電極、φ0.06タングステン電極を使用した3つの試作品を製作・検証を行い、穴径及び穴ピッチの精度に問題がないことを確認した。

事業化に向けての今後の取り組み

ウェアラブル端末用セラミック積層品の高性能化・微細化を実現するために確立した高精度な精密加工技術と、電極自動送り出し機能及びロボットを活用した電極自動交換装置を組み合わせることにより、夜間・休日無人運転を行い、リードタイム短縮、コストダウンにつなげ競争力強化を実現し、積極的な営業展開により、事業の拡大を図っていく計画である。



下型プレート（φ0.12）



φ0.12穴拡大



導入設備（細穴放電加工機）

S・U・Z・U・I・S・H・I・N

金型、治工具、精密部品はおまかせください

UP(Ultra Precision-超精密)への挑戦とIT(Information Technology-情報技術)への対応に少数精鋭で取り組みます。金型・治工具・精密部品の設計製作・加工開発・試作ならぜひ当社におまかせください。細穴放電加工、形彫放電加工、ワイヤーカット放電加工精密研削加工、マシニング加工を主体とした確かな技術で高品質な製品をお届けします。

企業 DATA

当社は創業当時より、精密打ち抜き金型の製造に取り組み昼夜技術向上の研鑽に努め、それが今日に至る礎となりました。その後、製品の高精度化が益々進展することを踏まえ、超精密加工を主体とする分野への展開を図り、放電加工を中心とする微細加工技術をベースに超硬材における微細放電の多数穴加工の無人運転など超精密製品の製造と技術開発に取り組んでいます。



工場外観

事業者	株式会社キンコー
代表者	代表取締役 吉見 嘉之
設立年月日	昭和52年4月
所在地等	〒899-1922 薩摩川内市小倉町7561番地 TEL 0996-26-3630 FAX 0996-26-3076 E-mail kinkoh@po2.synapse.ne.jp URL http://www.precision-kinkoh.com
資本金額	1,000万円
従業員	30名
業種	金属製品製造業